

KGK

#1 Coating Technology in The World
Molecule Gradient Layer (MGL)TM Technology

耐热酰亚胺基材遮蔽·半导体芯片固定用胶带

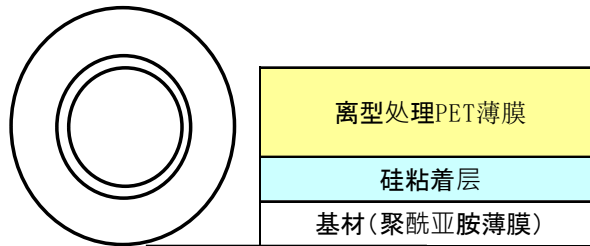
170 系列

特点

- ①使用焊料耐热聚酰亚胺薄膜基材的耐热胶带
- ②在玻璃、半导体上的残胶少。(171)
- ③提供轻剥离性(171)、强粘着性(172、174)等级

用途	171	用于C-MOS玻璃与C-MOS的遮蔽胶带
	175	用于C-MOS玻璃与C-MOS的遮蔽胶带
	172	引线框架(临时)固定胶带 (中粘着)
	174	引线框架(临时)固定胶带 (强粘着)

结构



特性

一般特性

产品名	(厚度) (mm)	(基材厚度) (mm)	粘着力 (N/25mm)
171	0.065	0.050	0.1
175	0.040	0.025	0.2
172	0.040	0.025	3
174	0.065	0.050	5
KX174(开发产品)	0.05	0.025	8

测定条件 引张速度 300mm/min

(JIS Z0237标准) 引张角度 180度

测定温度 23°C

贴合后24小时后的测量值

被粘物 不锈钢板

产品名	(基材厚度) (mm)	引张强度 (MPa)	拉伸 (%)	绝缘击穿电压 (KV/mm)
171	0.050	310	80	18
175	0.025	340	60	9
172	0.025	340	60	9
174	0.050	310	80	18

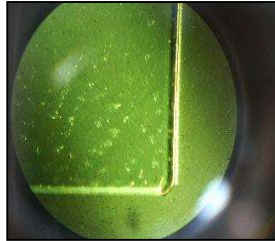
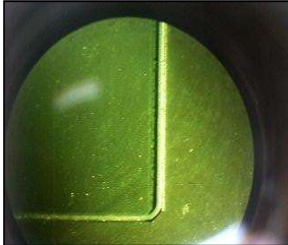
【171·175系】

玻璃·半导体·电路蚀刻耐热遮蔽用

(1)残留-1

171

一般的酰亚胺胶带



条件

粘贴在玻璃上后, 在250° C下放置1分钟

取出后, 在室温下空气冷却30分钟。→ 取下胶带, 观察玻璃表面

(1)残留-2

90°CX1hr

150°CX1hr

200°CX1hr

准备IC芯片与固定用胶带



条件

粘贴于不锈钢表面上后按照上述条件放置

取出后, 在室温下空气冷却30分钟。→ 取下胶带, 观察不锈钢表面

(2)耐药品性

在pH=2的酸性溶液(H₂SO₄水溶液)中浸渍1分钟。

【试验前】

【试验后】



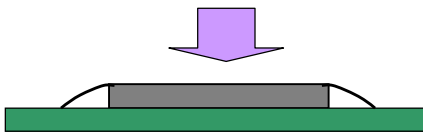


遮蔽工艺的应用案例

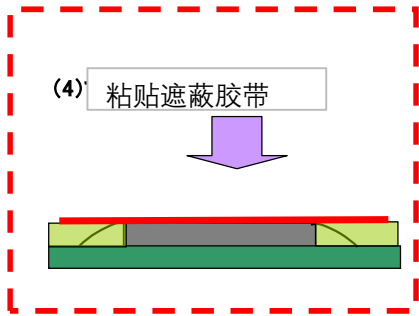
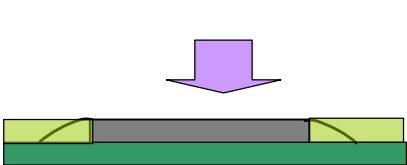
(1) CMOS形成



(2) 引线键合



(3) 树脂封装：CSP



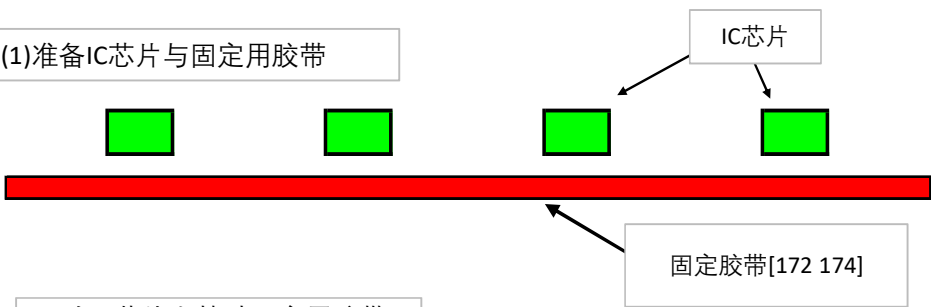
(4) 粘贴遮蔽胶带

返工工序

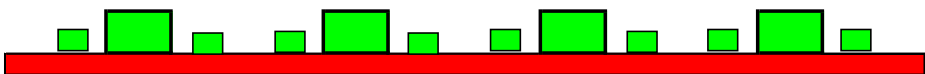
【172·174系】

IC封装成型时的固定胶带

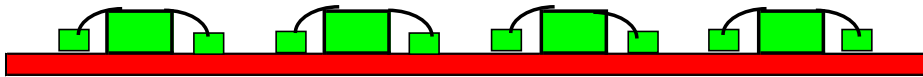
(1) 准备IC芯片与固定用胶带



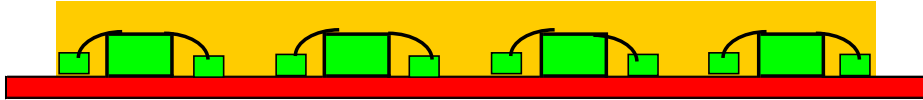
(2) 在IC芯片上粘贴固定用胶带



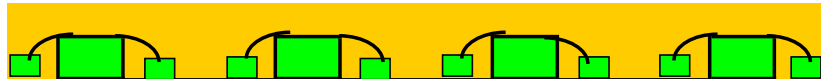
(3) 外围电路连接



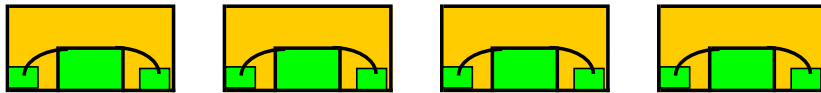
(4)树脂封装



(5)剥离胶带

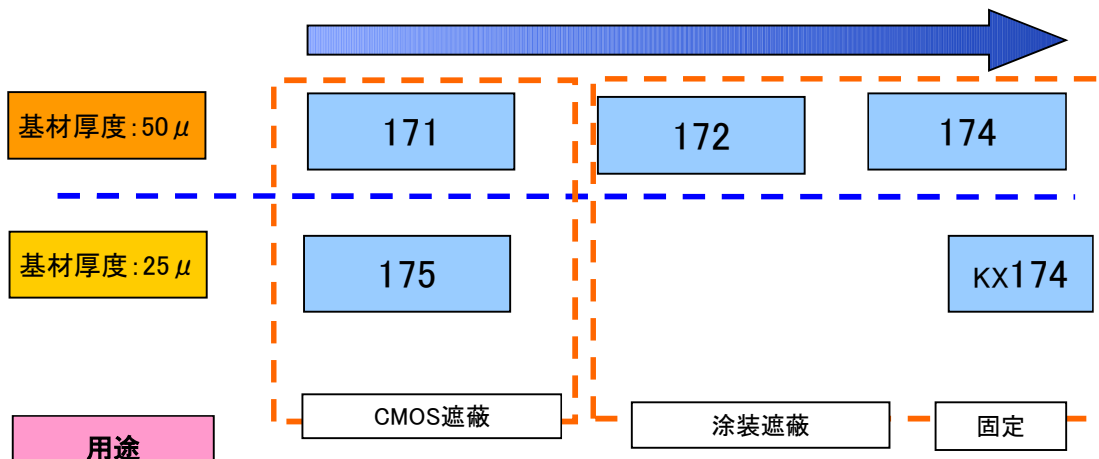


(6)切断、包装



产品选择

粘着	弱	强
残胶	无	略多



蚀刻遮蔽

使用注意事项

- 所有技术资料均根据共同技研化学实验室的测试与测量值编制。
但是产品特性可能会根据环境与被粘物的不同而发生很大的变化。
因此, 请理解这些特征数据是参考值而非保证值。
在使用本产品前, 请确保其适合预期的用途与环境。
- 以上是于室温(23°C)下的数据。在低温(5°C以下)时, 粘着力有可能急剧下降。

储存注意事项

- 务必置于盒中储存。
- 储存位置请选择避免阳光直射的阴凉处。
不要暴露在高温高湿(温度30°C以上 湿度50%以上严禁)环境下。

KGK Chemical Corporation.
940 Minaminagai Tokorozawa-city Saitama-pref
359-0011
TEL +81 4-2944-5151
Issue May,2019